

DK 3.34 Df 0.0037
@13GHz

T_g (DSC) 185°C

T288(銅付)
>120分

MEGTRON6

Laminate

R-5775(N)* R-5775(K) R-5775(G)

Prepreg

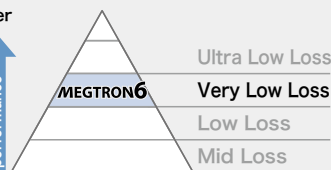
R-5670(N)* R-5670(K) R-5670(G)

*Low Dk glass cloth type

超低伝送損失・高耐熱多層基板材料

超高性能サーバやルータ向け材料のデファクトスタンダード。
低伝送ロスを実現し、超高性能サーバやルータの性能向上に貢献

Better
Transmission loss performance

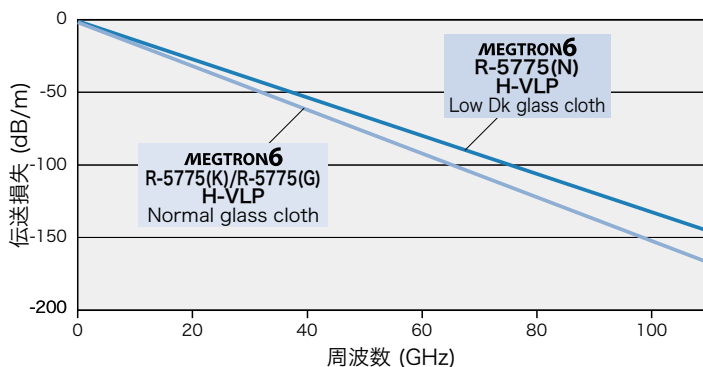


用途

ネットワーク/ワイヤレス通信

ICTインフラ機器(スーパーコンピュータ、計測用機器)、アンテナ(基地局、車載ミリ波レーダ)、高周波用途 など

伝送損失比較



高多層耐熱性

評価結果

ドリル径	φ0.3mm	
TH壁間距離	0.5mm	0.6mm
MEGTRON6 (Low Dk glass cloth)	pass	pass

評価条件

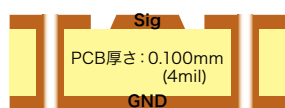
260°Cリフロー×10回

構成

32層
板厚: 4.5mm

構成

マイクロストリップライン



試験方法	2ポート Sパラメータ
試験周波数	10MHz-110GHz
校正方法	マルチラインTRL法
インピーダンス	50Ω(Z ₀)

層1: シグナルライン (ライン幅: 270μm、銅箔厚さ: 24μm)

層2: グランドプレーン (銅箔厚さ: 24μm)



一般特性

項目	試験方法	条件	単位	MEGTRON6 R-5775(N) Low Dk glass cloth	MEGTRON6 R-5775(K)/R-5775(G) Normal glass cloth
ガラス転移温度(T _g)	DSC	A	°C	185	185
熱膨張係数 (厚さ方向)	IPC-TM-650 2.4.24	A	ppm/°C	α1	45
				α2	260
T288(銅付)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分	>120	>120
比誘電率(Dk)	平衡円板共振器法	C-24/23/50	-	13GHz	3.34
誘電正接(Df)				0.0037	
銅箔引き剥がし強さ*	1oz(35μm)	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	0.8

試験片の厚さは0.75mmです。

* H-VLP銅箔

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。